

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年7月18日(2013.7.18)

【公表番号】特表2013-516061(P2013-516061A)

【公表日】平成25年5月9日(2013.5.9)

【年通号数】公開・登録公報2013-022

【出願番号】特願2012-545503(P2012-545503)

【国際特許分類】

H 01 L 21/677 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 C

【手続補正書】

【提出日】平成25年6月3日(2013.6.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

図1は、ワンド100の上面図であるが、図2は、ワンド部分の側面図である。この実施形態のワンドは、少なくとも200mm、または少なくとも300mm、または少なくとも400mmまたはいくつかの実施形態において少なくとも450mmの直径を有するウエハを輸送するように適合している。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体ウエハ輸送システムであって：

ベルヌーイの定理を用いてプレートの下でウエハがぶら下がるように気体の流れをウエハに誘導するための複数のプレート出口を有するプレート；および

ウエハをプレートに対して横方向に配置するように気体の流れを誘導するための配置出口を含んでおりプレートから延在している配置器；  
を含み、

ウエハがプレートおよび配置器に接触するのを防ぐように、プレート出口と配置出口が作動する、半導体ウエハ輸送システム。

【請求項2】

プレートが、平面を規定しており、および配置出口が、平面に対して0°～10°の間の角度で気体を誘導する、請求項1に記載のシステム。

【請求項3】

配置出口が、プレートの平面にほぼ平行に延在しているスリットである、請求項1に記載のシステム。

【請求項4】

配置器が、第1配置器であり、システムが、第1配置器から間隔を空けて第2配置器を更に含んでおり、第2配置器が、プレートに対してウエハを配置するための配置出口を含んでおり平面から延在している、請求項1に記載のシステム。

**【請求項 5】**

プレートが、そこに設置されており気体源をプレート出口及び／又は配置出口に接続している流路を含む、請求項1に記載のシステム。

**【請求項 6】**

プレートから延在しているネックと、プレートを配置するためにネックから延在しているアームとを更に含み、ネックが、気体源をプレート内の流路に接続するためにそこに流路を含む、請求項5に記載のシステム。

**【請求項 7】**

少なくとも1つのプレート出口が気体を平面に対して誘導している角度が、少なくとも1つの他のプレート出口が気体を平面に対して誘導している角度と異なる、請求項2に記載のワンド。

**【請求項 8】**

少なくとも1つのプレート出口が気体を平面に対して誘導している角度が、配置器に向けてウエハを付勢するように選択されている、請求項2に記載のワンド。

**【請求項 9】**

プレート出口が、円形形状であり、及び配置器が、ウエハの縁上に設置されている切欠きと係合するように構成されている、請求項1に記載のワンド。

**【請求項 10】**

プレートが円形であり、および配置器が、プレートの周囲に沿って互いに均等に間隔が空けられている、請求項4に記載のワンド。